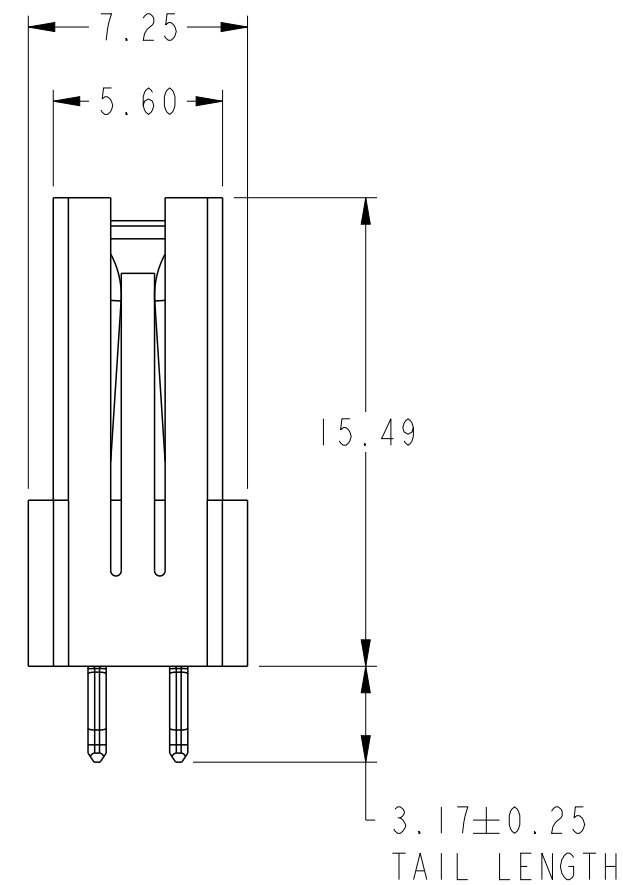
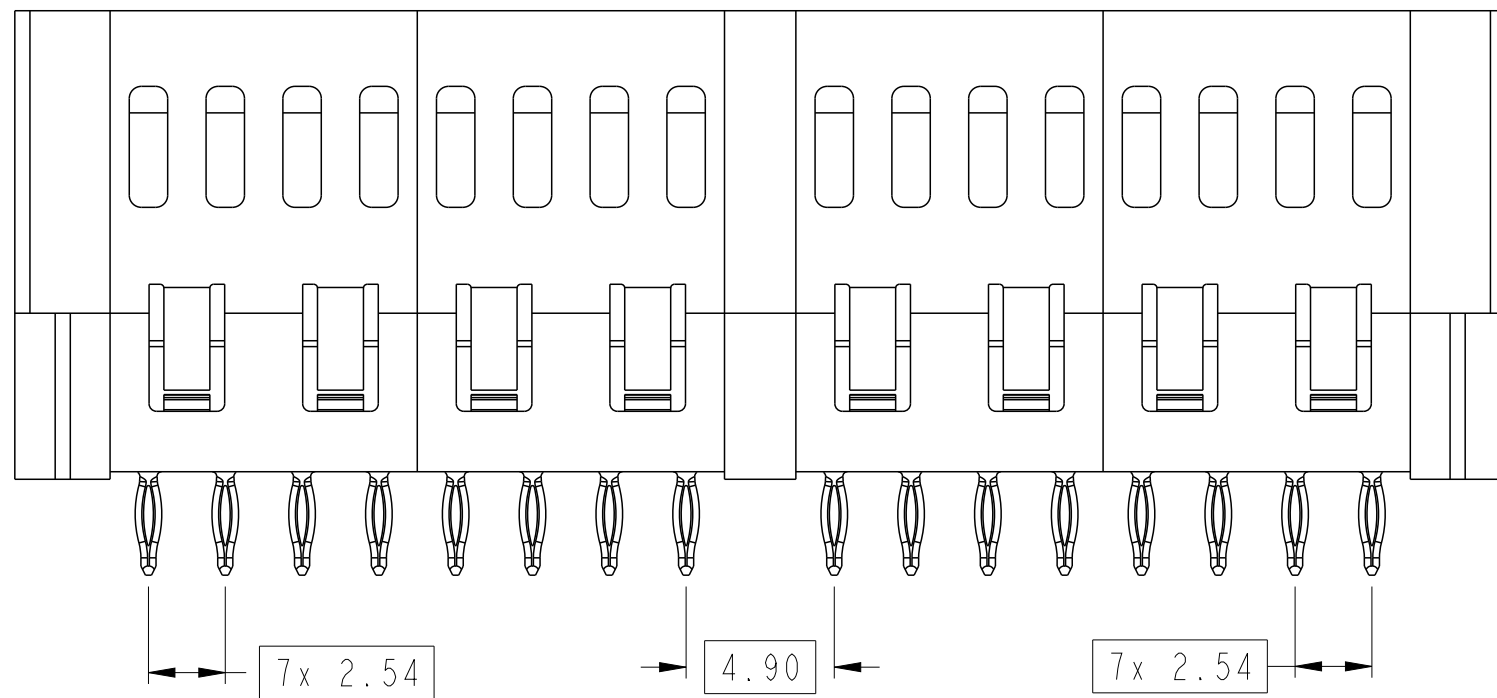
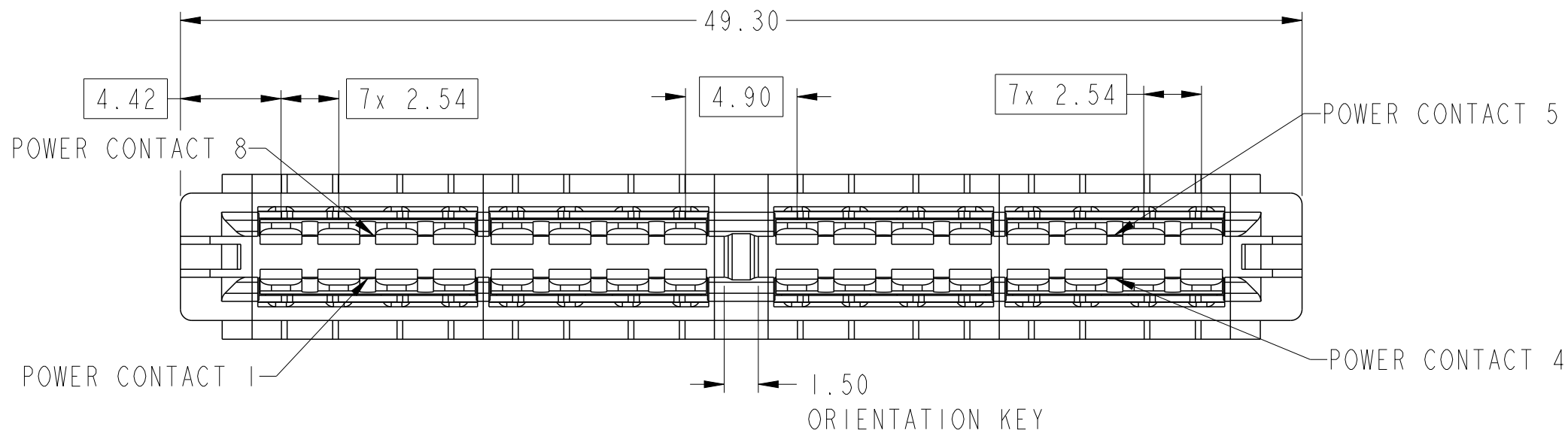
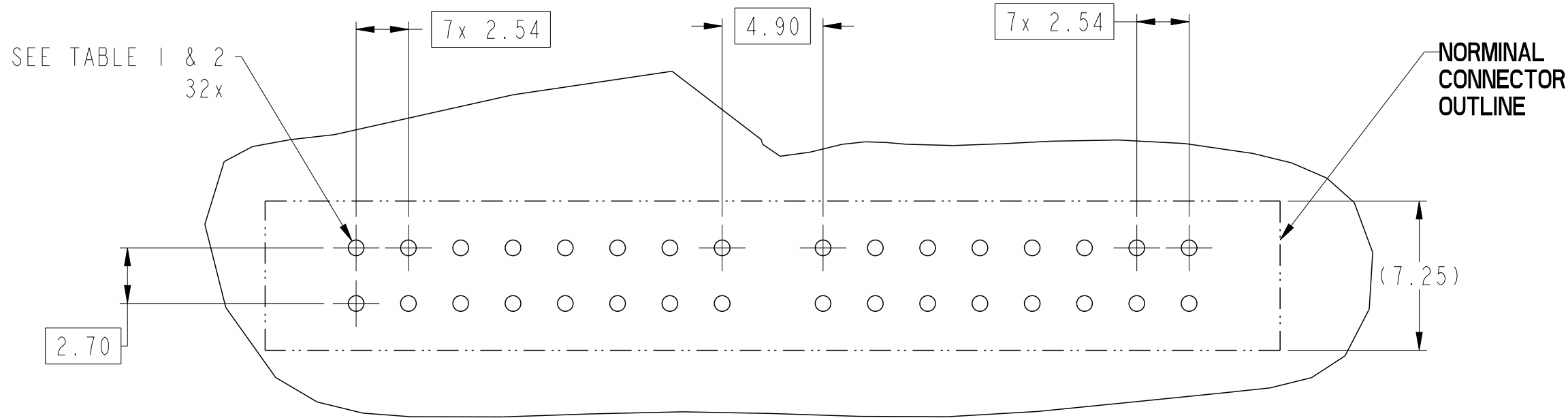


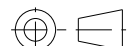


spec ref		dr		Jackie Huang	2014/12/17	projection	MM	size	A3	scale	2:1		
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng			Hai-Ling Liu	2015/01/12	ecn no	-		
					chr			-	-				
					appr			Pei-Ming Zheng	2015/01/12			product family	-
surface	linear	0.X	±0.5		title	HPCE MEZZANINE			dwg no	10132872		rev	A
		0.XX	±0.25										
		0.XXX	±0.100										
	ISO 1302	angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 1 of 4		

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 1 (HPCE / SOLDER TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.94 - 1.10
	IMMERSION TIN	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.94 - 1.10
	COPPER (SEE NOTE 8)	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.94 - 1.10
CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 2 (HPCE / PRESS-FIT TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.65 - 0.80
	IMMERSION TIN	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.70 - 0.80
	COPPER (SEE NOTE 8)	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.70 - 0.80



RECOMMENED HOST BOARD

spec ref				dr Jackie Huang		2014/12/17		projection  MM 		size A3		scale 2:1			
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng Hai-Ling Liu				2015/01/12		ecn no -			
ISO 406 ISO 1101						chr -				-		rel level Released			
		appr Pei-Ming Zheng		2015/01/12		product family -									
surface  ISO 1302		linear		0.X		±0.5				title HPCE MEZZANINE		dwg no 10132872		rev A	
				0.XX		±0.25									
				0.XXX		±0.100									
angular		0°		±2°		www.fci.com		cat. no. -		Product - Customer Drw				sheet 2 of 4	



Copyright FCI.

A

B

C

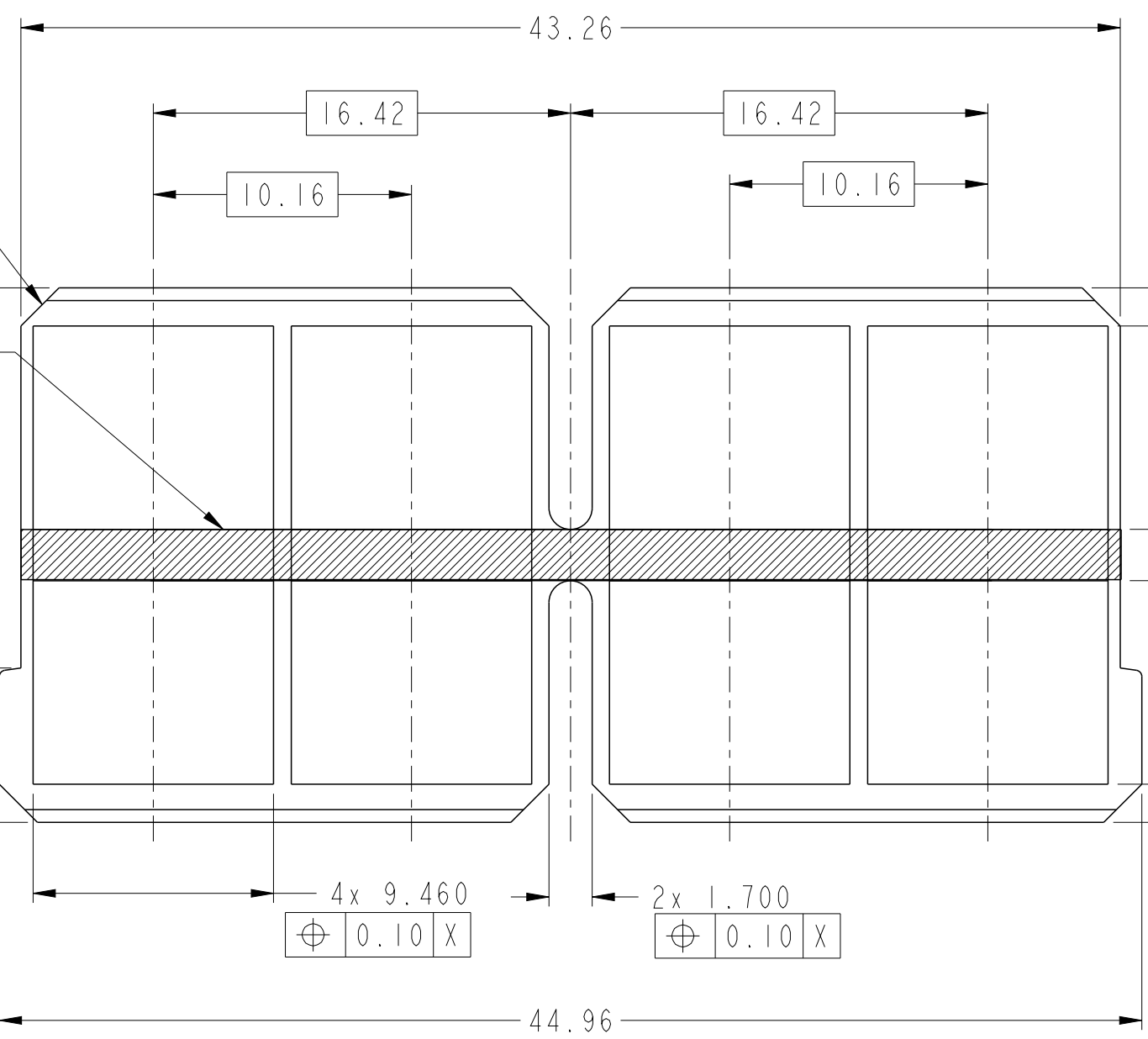
D

DIM "L"
SEE TABLE 3

8x C1.50

HATCHED IS
SOLDER MASK
AREA

2x 6.07



DIM"L" (±0.25)	MEZZANINE STACK HEIGHT (±0.50)
21.02	32
22.02	33
23.02	34
24.02	35
25.02	36
26.02	37
27.02	38
28.02	39
29.02	40
30.02	41
31.02	42
TABLE 3	

A

B

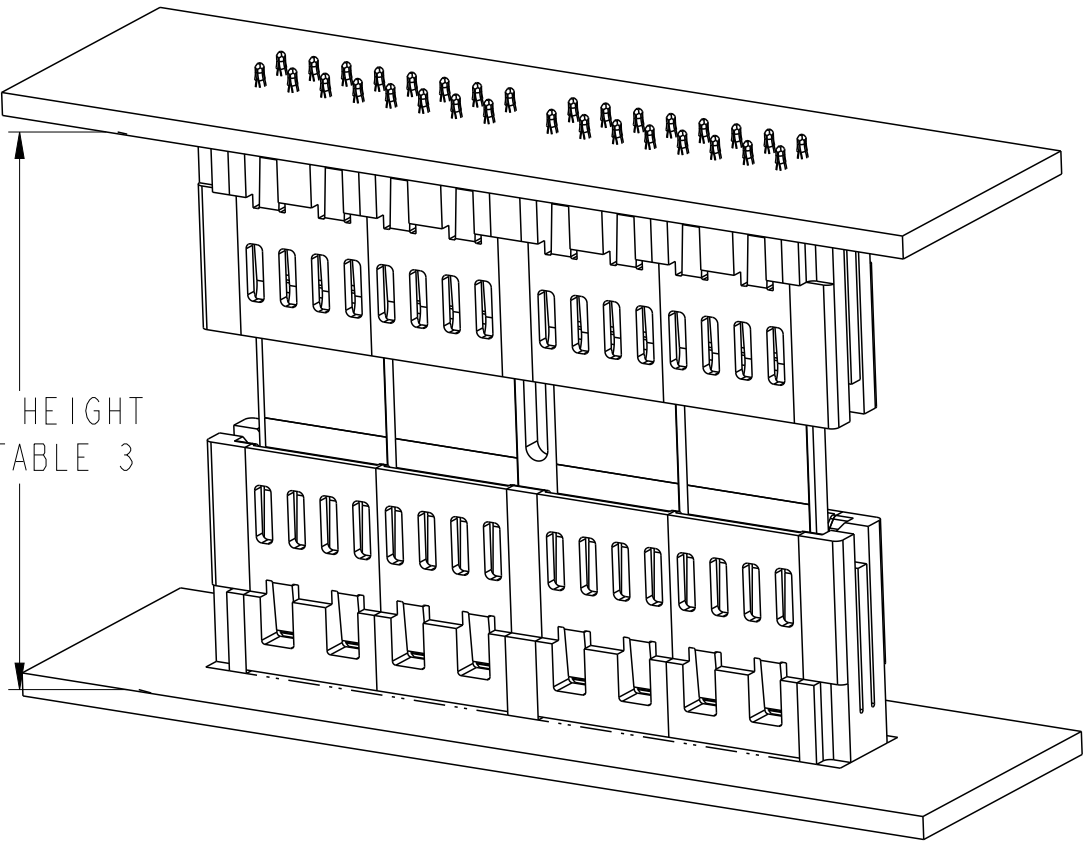
C

D

RECOMMENDED BRIDGE PCB

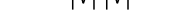
spec ref		dr		Jackie Huang	2014/12/17	projection		MM		size	A3	scale	2:1			
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	eng		Hai-Ling Liu	2015/01/12					chr	-	-	ecn no			-
		appr		Pei-Ming Zheng	2015/01/12								product family			-
ISO 406 ISO 1101																
surface - ✓ ISO 1302	linear	0.X	±0.5		title	HPCE MEZZANINE 8HP			dwg no	10132872			rev	A		
		0.XX	±0.25													
		0.XXX	±0.100													
angular		0°	±2°	www.fci.com		cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 3 of 4					

PART NUMBER	TAIL TYPE
10132872-001LF	SOLDER
10132872-002LF	PRESS-FIT
TABLE 4	



NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:
- HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
- CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
2. CONTACT FINISH REF. GS-12-1261 SECTION 5.2.
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1261.
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.
5. PRODUCT MARKING (FCI - PART NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.
6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.
7. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
8. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
9. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.

spec ref		dr		Jackie Huang		2014/12/17		projection		MM		size		A3		scale		2:1			
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng		Hai-Ling Liu		2015/01/12						ecn no		-		-			
ISO 406				chr		-		-													
ISO 1101				appr		Pei-Ming Zheng		2015/01/12												product family	
surface 		linear		0.X		±0.5				title		HPCE MEZZANINE		dwg no		10132872		rev		A	
				0.XX		±0.25															
				0.XXX		±0.100															
		ISO 1302		angular		0°		±2°		www.fci.com		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 4 of 4			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9